

联系人:

Arnaud Brulé
Synova SA

电话: +41-21-694-3500

电话: +41-21-694-3501

电子邮件: brule@synova.ch

Martin Plankensteiner
DISCO HI-TEC EUROPE GmbH

电话: +49-89-90903-202

电话: +49-89-90903-298

电子邮件: <mailto:mmpl@discoeuropa.com>

Wang Min
Strategic PR Group

电话: (86) 10 8580 4258 – 217

传真: (86) 10 8589 1963

电子邮件: min.wang@sprg.com.cn

立即发布

SYNOVA 牵手 DISCO 科技欧洲公司，联合开发混合切割工具

***Disco 的刀片和 Synova 的水刀激光技术相融合，
必将创造出革命性的混合切割解决方案***

瑞士洛桑以及德国慕尼黑，2007年6月12日讯—瑞士喜诺发公司（Synova SA）于今日宣布公司与设在慕尼黑的迪思科科技（Disco）欧洲有限公司达成了一项合作伙伴协议，迪思科科技（Disco）欧洲有限公司是业界领先的半导体晶圆切割、研磨以及抛光机械设备供应商 Disco Corporation 的子公司，这一举措必将极大地推动其创新的微水刀激光（水射流引导激光）技术在全球范围内的拓展。根据合作协议中的条款，双方将展开紧密合作，将 Synova 公司专利的 Laser MicroJet® 技术与 Disco 公司最新一代的钻石刀片切割系统整合在一起，开发出针对高级切割应用的混合切割工具。毫无疑问，合作产生的最佳解决方案将满足半导体制造商们对于更高的产能以及对任意厚度的硅晶圆和新型高级材料晶圆产生最小损伤的双重需求。公司的正式报告显示，首套组合工具将于 2007 年底正式面市。

Synova 首席执行官 Bernold Richerzhagen 博士表示：“这一合作伙伴关系代表了 Synova 公司一个重要的里程碑——同时也是整个半导体封装领域的重要里程碑，”他继续强调说：“Laser MicroJet 带来了之前传统切割技术根本无法实现的性能优势。日前，受到市场需求的驱动，我们适时地抓住了机会，与这一领域领先的公司结成了合作伙伴关系，以期能够开发出新型的切割系统，最大限度地结合双方公司久经业界考验的技术优势。Disco 科技公司的市场营销资源以及遍及全球的支持和分销架构与我们在激光技术、工艺和应用等领域的领先地位形成了完美的互补。我们期待双方的通力合作能够加速这一 21 世纪最佳组合的切割系统的商业化进程。”

Disco 科技欧洲公司执行副总裁 Karl Heinz Priewasser 表示道：“Synova 公司的水射流引导激光为多种制程提供了许多有价值的益处。我们深信，Synova 的技术与我们前沿的产品相融合，必将获得一个能使我们的用户充分利用双方公司最佳技术的解决方案。”

-更多内容-

SYNOVA 牵手 DISCO 联合开发混合切割工具 PAGE 2 OF 3

尽管协议条款仅限于就 Disco 刀片系统进行联合开发，协议仍然允许双方投入研发力量，加快 Synova 核心技术成功地整合到 Disco 之行业领先系统，以确保能够满足客户最严苛的需求。双方将共同投入混合工具的生产制造，共同分担市场和营销。这一合作伙伴关系能够使两家公司的特种商业和技术优势发挥杠杆作用，同时又使各自能继续自由地推广和直销自己的独立切割系统，并继续各自的技术研发。

对于体积更小、功能更多的消费产品永不满足的需求为集成电路制造商带来新的挑战，迫使他们必须把更多的功能压缩到越来越小的 IC 封装里。为此，封装行业面临的主要挑战之一是芯片制造商们引进了层次更复杂的新型晶圆材料，使得晶圆在传统切割技术处理下变得脆弱和易损。达成这一合作关系旨在融合 Disco 科技的钻石刀片和 Synova 公司的 Laser MicroJet 技术，赋予了制造商们针对当前和下一代 ICs 的切割解决方案，经济有效，满足了严苛的良率和产能需求。

除了半导体封装之外，Synova 公司多用途的 Laser MicroJet 技术适用于 IC 行业内的其它应用，以及其它的核心市场，包括平板显示器、太阳能电池、医疗器械以及汽车器件等领域—公司还将继续针对这些应用开发并营销自己的前沿激光系统。而且，Synova 授权其 Laser MicroJet 技术之新近举措，预计将刺激其技术在其它行业 and 应用的衍生和使用。目前，公司正在与一些主要的技术推动者进行磋商，包括领先的公司、研究机构和大学，他们既有的地位和知识必将为终端用户实现意义深远的增值。

Laser MicroJet®技术背景

Synova 公司的 Laser Microjet 技术是融合了激光束和水刀的革命性混合切割工艺，通过如发丝般纤细的水射流将激光束引导到晶圆上。利用空气和水的折射率之间的区别，Laser MicroJet 之激光束可以在空气-水的界面全反射，原理类似光纤。由于在工件上和工件之外实现了零偏差，因此促进了多孔材料或分层材料的精确切割。此外，与标准的划片方式相反，Laser MicroJet 技术使用水射流来冷却材料表面，避免了材料表面的热损伤，从而获得了理想的保护。同时，水流也形成了一个自然的保护层，避免了附着和污染。上述两个表面保护的属性使得标准的划片工艺得到了重要的改进，进而大幅度提升了器件的良品率。

-更多内容-

Disco 公司简介

总部位于日本东京的 Disco Corporation 主营业务为制造、销售和维修精密切割、研磨以及抛光机械设备；提供培训和售后服务；精密切割、研磨和抛光机械设备的拆卸再利用，以及制造并销售精密钻石磨削工具。公司的主要产品包括划片和切割机、激光/刀片划片机、研削机和抛光机、切割刀片、研削磨轮、干式抛光研磨磨轮、周边设备以及用于固定和运输工件的框架和晶片盒等。Disco Corporation 在日本仙台、东京、诹访、名古屋、大阪和熊本都设有办事机构，在广岛设有制造工厂。公司在美国、亚洲和欧洲亦有运营。Disco Corporation 共拥有 15 家分支机构和 5 家关联公司。关于公司的更多信息，请访问户联网址 www.disco.co.jp。

Synova 公司简介

瑞士 Synova（喜诺发）公司始创于 1997 年，是顶级微水刀激光（水射流引导激光）技术 Laser MicroJet®的发明者和专利拥有者，该项技术通过组合激光束和水刀的优势，满足了半导体、平板显示器、太阳能电池、医疗器械以及汽车电子等器件量产过程中严苛的制造规范需求，实现了较低的拥有成本（CoO）。籍由这一创新的技术，Synova 公司正在大力革新在这些核心市场中的布局，同时，迅速发展成为这些领域中高精度激光应用的理想供应商。总部坐落于瑞士洛桑的 Synova 公司是私人控股公司，在中国香港、韩国、日本以及美国等地均设有办事机构。关于公司的详细信息请访问互联网地址：www.synova.ch

Laser MicroJet®是Synova公司的注册商标。

###